

令和7年8月27日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム  
半導体製造センシング・実装技術WG

主査 日下 靖之

副査 岩崎 渉、坂田 義太郎、竹井 裕介

## 令和7年度 第2回 半導体製造センシング・実装技術WGのご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。本WGでは、次世代パッケージング技術やその製造・検査等におけるスマートセンシング、インフォマティクス融合など、半導体製造センシング・実装技術に関し、情報共有と議論を通して技術開発要素の課題抽出やプロジェクト提案・実施を目指します。今回は、公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団福岡超集積半導体ソリューションセンターの後工程開発拠点のご見学と講演会、産業技術総合研究所九州センターの製造センシング技術のご見学・交流検討会を企画しています。ご出席宜しくお願い致します。9月12日(金)までに参加のご意向をご連絡いただけますと幸いです。

敬具

記

日時： 2025年10月10日(金) 9:30～15:55

会場： (午前) 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 福岡超集積半導体ソリューションセンター

(午後) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九州センター

9:20 JR 筑肥線 筑前原駅集合 (マイクロバスで福岡超集積半導体ソリューションセンターへ移動)

9:30～9:35 開会挨拶

半導体製造センシング・実装技術 WG 副査 坂田義太郎

9:35～10:05 福岡超集積半導体ソリューションセンターの活動について

福岡超集積半導体ソリューションセンター 副センター長 野北寛太 様

10:05～10:40 ご見学(福岡超集積半導体ソリューションセンター)

10:40～12:40 (産総研九州センターへ移動+昼食) ※お弁当の可否について事前アンケートで伺わせていただきます。

12:40～13:10 参加者様の簡単な自己紹介、産総研九州センターの紹介

産業技術総合研究所 センシング技術研究部門 副研究部門長 山下健一

13:10～14:30 ご見学(産総研九州センター)

※ ウェハ潜傷検査技術、めっきプロセスセンシング技術、プラズマプロセスモニタリング技術、  
静電気可視化技術、接着状態可視化技術

14:30～14:40 休憩

14:40～15:20 招待講演「半導体・光電融合のための表面活性化低温接合技術」

九州大学 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 准教授 多喜川良 様

15:20～15:50 交流検討会

※ ワーキンググループとして検討を深めるべき方向性を探る機会といたします。

15:50～15:55 閉会挨拶、事務連絡等

半導体製造センシング・実装技術 WG 主査 日下靖之

16:08 文化会館前発バスにて鳥栖駅に移動できます。(16:16 鳥栖駅着 ※遅れる可能性有)

お問い合わせ先: 半導体製造センシング・実装技術 WG 事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

E-mail: M-stri-SenTePack-smapack-ml@aist.go.jp